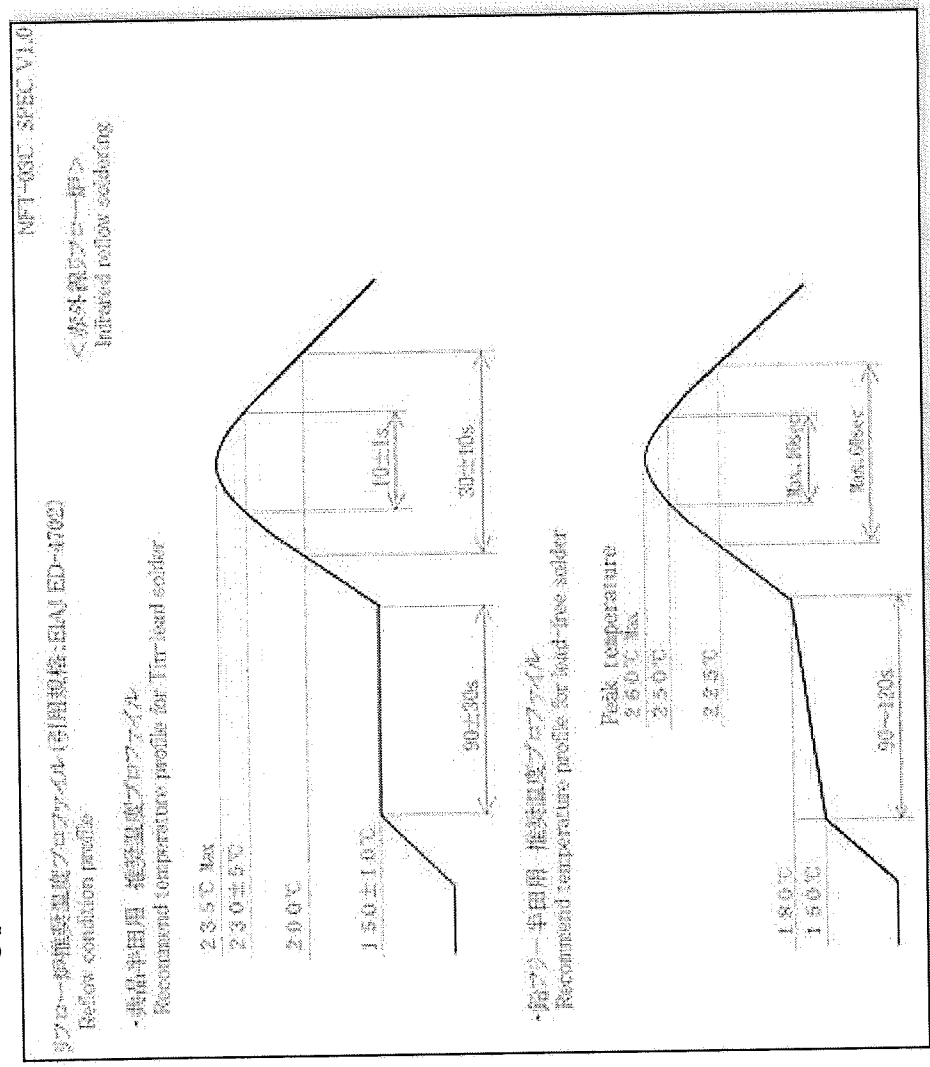


NFT-03C:

<p>端子半田付性試験 Solderability</p>	<p>40°C, 90~95%RHにて240時間放置後、半田槽に浸漬 溶解半田温度 235°C±5°C 半田浸漬時間 2±0.5秒 Pretreatment: 40°C, 90~95%RH×240 hrs. Soldering into solderbath: Solder Temp. 235±5°C Soaking Time 2±0.5sec</p>	<p>端子表面の95%以上が 新しい半田で覆われ、 欠陥が生じぬ事。 95% surface of lead pins must be covered with fresh solder and no soldering holes should be found.</p>	<p>JIS C 0050 IEC68-2-20</p>
-----------------------------------	--	---	----------------------------------

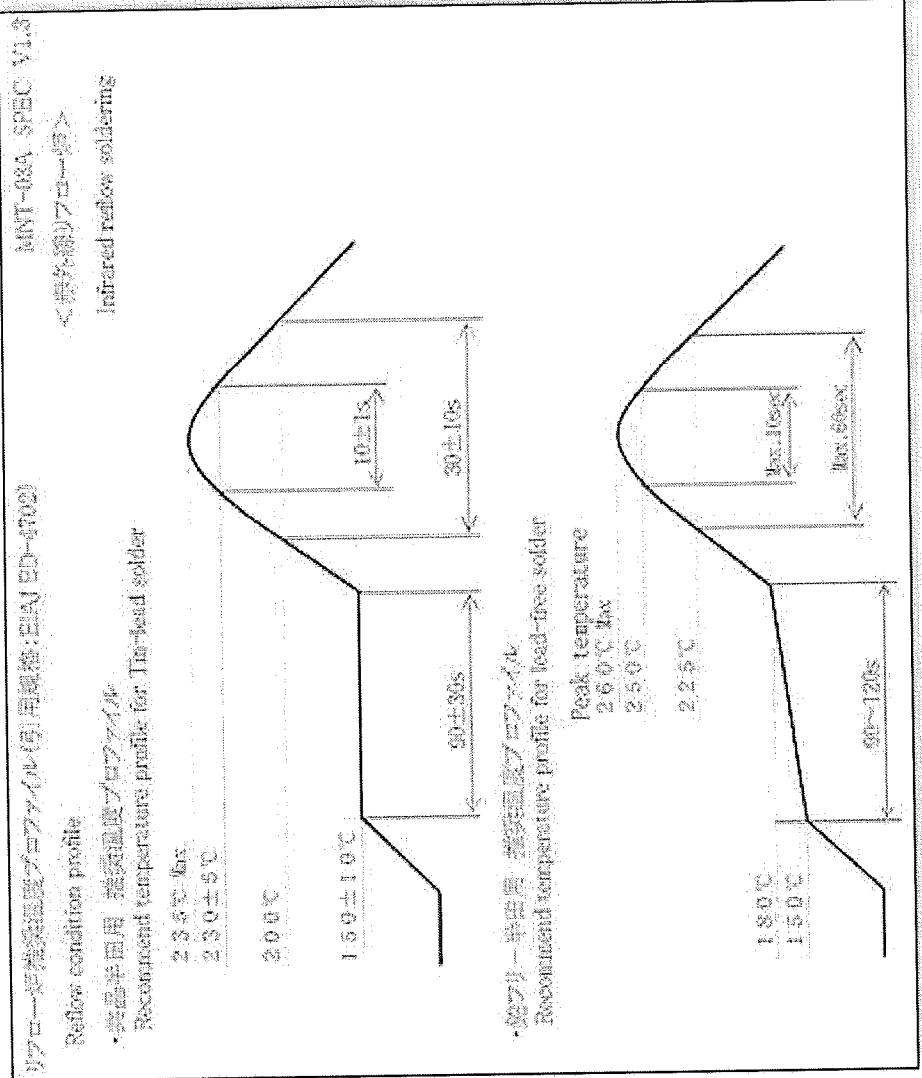
soldering profile



MNT-03A:

<p>端子半田付性試験 Solderability</p>	<p>40°C, 90~95%RHにて240時間放置後、半田槽に浸漬 溶解半田温度 235°C ± 5°C 半田浸漬時間 2 ± 0.5秒 Pretreatment: 40°C, 90~95%RH × 240 hrs Soldering into solderbath: Solder Temp. 235 ± 5°C Soaking Time 2 ± 0.5sec</p>	<p>JIS C 0050 IEC 68-2-20</p> <p>端子表面の95%以上が新しい半田で覆われ、鉛酸が主である。 95% surface of lead pins must be covered with fresh solder and no soldering holes should be found.</p>
-----------------------------------	---	--

soldering profile



MUT-03A:

<p>端子半田付性試験 Solderability</p>	<p>40°C, 90~95RHにて240時間放置後、半田槽に浸漬 溶融半田温度 235°C±5°C 半田浸漬時間 2±0.5秒 Pretreatment: 40°C, 90~95RH×240 hrs Soldering into solderbath: Solder Temp. 235±5°C Soaking Time 2±0.5sec</p>	<p>端子表面の95%以上が 新しい半田で覆われ、 空洞が生じぬ事。 95% surface of lead pins must be covered with fresh solder and no soldering holes should be found.</p>	<p>JIS C 0050 JEC68-2-20</p>
--	---	--	---

MUT-08A SPEC V2.0

リフロー炉推奨温度プロファイル (引用規格：EIAJ ED-4702) Reflow condition profile

<赤外線リフロー炉>
Infrared reflow soldering

